

# TECA 電子連接產業升級研討會

## 【高效能電子散熱：從液冷模擬到 AI 伺服器應用】

主辦單位：TECA 台灣電子連接產業協會

地點：工研院中興院區(新竹縣竹東鎮中興路四段195號)

時間：2026年6月23日(二)

大綱	◆液冷熱模擬技術及應用 ◆熱介面材料技術與發展 ◆AI 伺服器液冷散熱趨勢及技術發展	
適合聽課對象	適合伺服器及 3C 電子產業之理工背景學員。	
預期效益	本課程內容涵蓋 AI 伺服器及 3C 電子產業散熱相關技術人員常見的模擬軟體能力與應用介紹、熱介面材料與應用發展趨勢、AI 液冷散熱趨勢及技術發展，透過液冷模擬設計、介面熱傳材料、液冷散熱技術的導入，可讓學員具備電子散熱的基礎能力，理解常見的散熱技術，導入現實散熱應用以解決問題、突破思維，為電子散熱領域注入新活水。	
講師	林健文(現職：技術經理/某科技公司，專長：CFD熱流模擬分析) 朱旭山(現職：工研院材化所正研究員，專長：導熱材料及散熱模組) 劉君愷(現職：博士/某科技公司，專長：電子散熱結構設計)	
09:00-10:50	液冷熱模擬技術及應用	林健文 經理
11:00-12:00	熱介面材料技術與發展(1)	朱旭山 博士
12:00-13:00	午餐時間	
13:00-14:00	熱介面材料技術與發展(2)	朱旭山 博士
14:20-16:20	AI 伺服器液冷散熱趨勢及技術發展	劉君愷 博士

★費用：<AI聯盟會員免費2名> 會員NT\$3,800元/人；非會員NT\$7,500元/人

**第2位以上報名→半價** (請課程五日前完成匯款始算報名並享優惠) (費用含講義/稅，手續費用請自付)

註：1. 欲取消報名需於課程5日前告知，逾時或當日未到課者，恕不退費亦不接受變更其他課用；

2. 課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

★參加辦法：請先**傳真報名**或**線上報名**並來電確認

匯款或轉帳，土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會

★聯絡電話：(03)5910002 林小姐，5910003朱小姐

傳真：(03)5910009

★因颱風…等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。



### ◎ 台灣電子連接產業協會研討會 報名表 ◎

公司全銜	(發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他_____)			
聯絡地址	統一編號	傳真		
E-mail	聯絡人	電話		
參加者姓名	職稱/工作部門	手機	mail	午餐
				<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷
				<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷
費用共計新台幣	元整，支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳 <input type="checkbox"/> 現場繳費(酌收5%作業費)			

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印)1150623電子散熱